

RL78/L1C GROUP "SOLDERING CONDITIONS TABLE"

パッケージ名 Package	型名 Part Number	赤外線リフロ条件 INFRARED REFLOW SSD-A-M5658-2 (JP) SSD-A-M5659-1 (EN)	ウェーブソルダーリング条件 WAVE SOLDERING SSD-A-M5660-3 (JP) SSD-A-M5661-1 (EN)	部分加熱条件 PARTIAL HEATING SSD-A-M5662-1 (JP) SSD-A-M5663 (EN)
80pin plastic LQFP (12 x 12)	R5F110MxAFB	○	/	○
	R5F110MxGFB			
	R5F111MxAFB			
	R5F111MxGFB			
100pin plastic LQFP (14 x 14)	R5F110PxAFB	○	/	○
	R5F110PxGFB			
	R5F111PxAFB			
	R5F111PxGFB			

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件
 [温風、赤外線+温風リフロを含む]


吸湿量管理品

MSL3

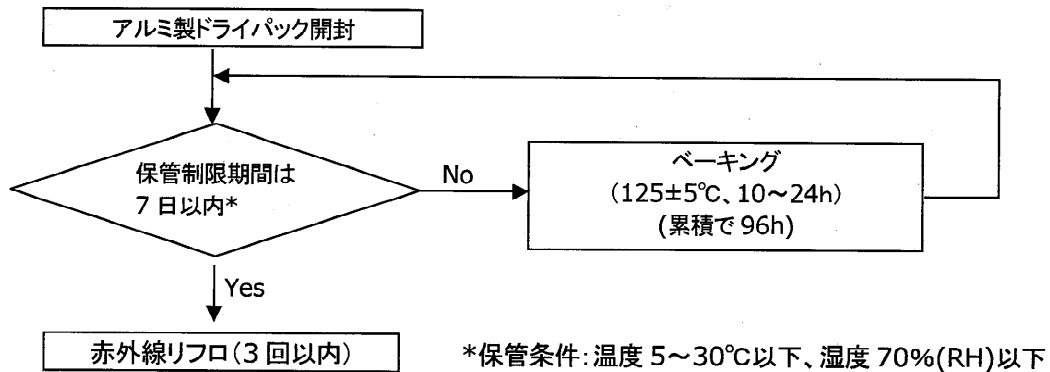
SSD-A-M5658-2

2012年 6月 27日

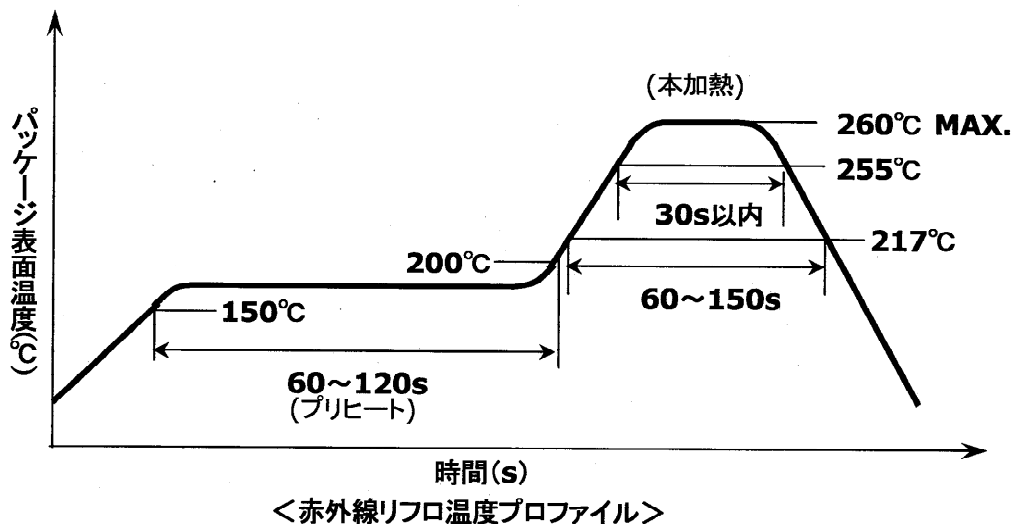
ルネサスエレクトロニクス株式会社
 品質保証統括部 MCU 品質保証第二部

承認		査閲	—	作成	東口
----	---	----	---	----	----

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(260°Cの場合) : 260°C MAX
- ピーク温度(-5°C)の時間 : 255°C 30s 以内
- はんだ融点以上(217°C以上の時間) : 60~150s
- プリヒート領域(150~200°Cの時間) : 60~120s
- 最多リフロ回数 : 3回
- ドライパック開封後の保管制限期間 : 7日以内



留意事項

- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの30%検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用お願いいたします。

**RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF
INFRARED REFLOW
[INCLUDING CONVECTION, INFRARED/CONVECTION]**

Moisture sensitive device

MSL3

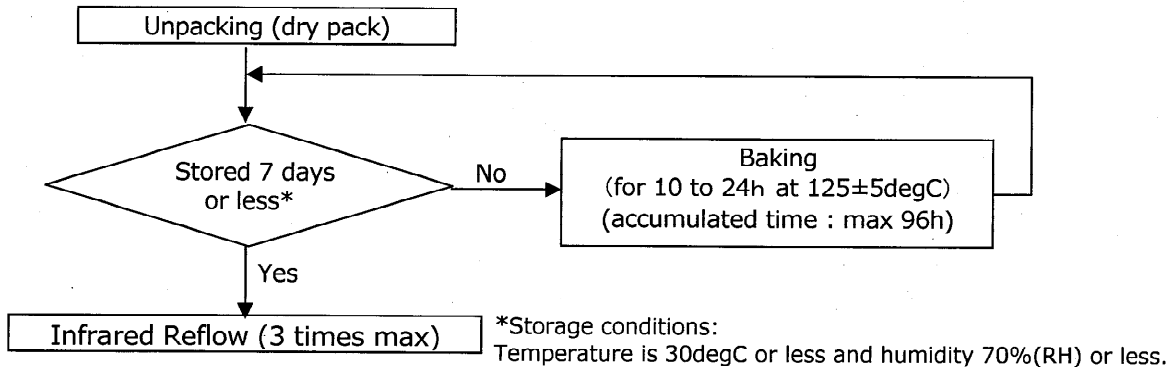
SSD-A-M5659-1

June 27, 2012

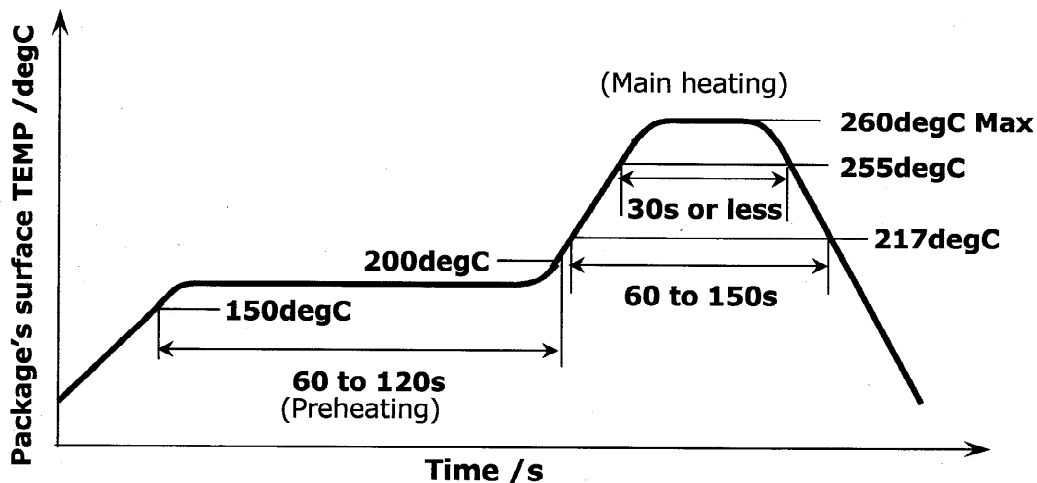
Renesas Electronics Corporation.
Quality Assurance Division.
2nd. MCU Quality Assurance Dept.

Prepared	Checked	Approved
Higashiguchi	-	<i>n. Sun</i>

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.




- Maximum temperature (Package's surface TEMP) : 260degC or below
- Maximum time for temperature higher than 255degC : 30s or less
- Time for temperature higher than 217degC : 60 to 150s
- Preheating time (150 to 200degC) : 60 to 120s
- Maximum number of reflow processes : 3 times
- Keeping limitation period after opening dry pack : 7 days or less



<Infrared Reflow Temperature Profile>

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">表面実装部品</div>	SSD-A-M5662-1				
	2011年 11月 10日				
	ルネサスエレクトロニクス株式会社 品質保証統括部 MCU 品質保証第二部				
	承認		査閲	—	作成

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

- 最高温度(端子温度) : 350°C以下
- 時間(パッケージの一辺あたり) : 3s 以内
- 最多回数 : 1回

RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS OF PARTIAL HEATING <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Surface mount device</div>	SSD-A-M5663		
	July 8,2011		
	Renesas Electronics Corporation. Quality Assurance Division. 2nd. MCU Quality Assurance Dept.		
	Prepared	Checked	Approved
	Higashiguchi	-	<i>M. Iano</i>

The following is recommended soldering conditions of partial heating.

- Maximum temperature (Pin temperature) : 350degC or below
- Time (per side of the device) : 3s or less
- Maximum number of heating processes : 1time